		セミナー時間割 a		内訳()														2010.03.02	
			講義日	時間	商品開発	商品設計分類	制御回路種類	使用電子部品	基板設計工程	基板設計種類	基板設計仕樣	基板材料仕樣	基板製作仕樣	基板製造工程	基板実装仕樣	実装工程	規格	その他	備考
1		進め方の説明	1日目	09:15-09:35															
2		序説	3日目	09:35-10:15															
3		部品データベースの作成		10:25-13:35															
		環境設定(設計条件等)		13:35-16:15															
		回路設計(回路図の作成)		09:15-10:45															
		基板設計の予備知識		10:45-14:15															
		基板設計(準備:17種類)		14:15-16:15															
		基板設計(両面基板)		09:15-11:35															
		基板設計(片面基板)		11:35-12:00															
		基板設計(4層基板)		13:00-14:10															
	講義 + 6	基板設計(6層基板)		14:20-15:20															
	C A D	基板設計(ビルド6層基板)		15:20-16:15															
	編集	設計変更		09:15-11:40															
		データ相互間の検証		11:40-11:50															
		B Dピュワによる検証		11:50-12:00															
		構造検証		13:00-13:05															
		検図検証		13:05-13:20															
		面付け設計 (パ 礼)		13:20-14:35															
		出図図面の作成		14:45-15 : 20															
		製造データの出力		15:20-15:45															
		設計例の紹介		15:45-16:15															

休憩は午前午後各10分間を基本とする。 の内容を織り交ぜながら、CAD実践設計を行う。